

## Siliconfreie Wärmeleitpaste

### TYP WLC / WLX

#### Anwendungsbereich:

WLC / WLX Wärmeleitpaste gewährleistet Betriebssicherheit sowie schnelle und sichere Wärmeleitung bei der Verbindung von Halbleiter zu Kühlkörper.  
WLC / WLX sollte immer dann zum Einsatz kommen, wenn die Gefahr der Verschmutzung durch Silicone besteht.

#### Verwendungszweck:

WLC / WLX kann den Wärmewiderstand zwischen Halbleiterelementen und Kühlkörpern wesentlich reduzieren.  
WLC / WLX wirkt elektrisch isolierend und paßt sich den Unebenheiten der Oberfläche an.

#### Besondere Eigenschaften:

WLC / WLX ist oxydations- und alterungsbeständig, hat großen Temperatureinsatz, ist nicht toxisch, ist geruchsneutral, hat geringe Ölabscheidung, einen sehr niedrigen thermischen Widerstand und ist weitgehendst chemisch indifferent den verwendeten Werkstoffen aus Metall und Kunststoff. Die dielektrischen Eigenschaften ändern sich in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur nur gering.  
WLC /WLX läuft durch thermische Beanspruchung weder aus, noch kommt es zu Austrocknung oder Verhärtung.

#### Technische Daten:

Dickungsmittel:	pulverisierte Metalloxide
Tropfpunkt:	n. meßbar (DIN ISO 2176) °C
Ruhpenetration 24 h:	265 - 295 (DIN ISO 2137) °C
Dichte bei 20 °C:	WLC: 2.240 g / cm <sup>3</sup> , WLX: 2.500 g / cm <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit:	WLC: 0.840 W / mk, WLX: 1.000 W / mk
Gewichtsverl. n. 96 h / 200°C:	WLC: 0.500 %, WLX: 0.100 %
Ausbluten:	WLC: 0.400 %, WLX: 0.400 %
Dielektrizitätskonstante:	WLC: 4.200 / 10 HZ, WLX: 4.500 / 10 HZ
Spez. Widerstand:	10.15 Ohm / cm
Durchschlagsfestigkeit:	WLC: 42.000 KV/mm, WLX: 56.000 KV/mm
kin. Viskosität bei 40 °C:	90 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
kin. Viskosität bei 100 °C:	13 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Flammpunkt:	WLC: 200 °C, WLX: 300 °C DIN ISO 2592
Pourpoint:	WLC: -40 °C, WLX: -25 °C DIN ISO 3016

Best.-Nr. E0023-0009, Typ WLC, 250 ml